

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|--------------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（华金、国金、东方证券组织“我是股东”走进上市公司活动） |
| 参与单位名称/人员信息 | CENTERLINE INVESTMENT 华商基金 申万宏源 J. P. Morgan 华泰保兴 深圳南杉 Khazanah Nasional Berhad 华泰证券 深圳纽富斯 KS capital 华泰资管 深圳奇盛 P72 华源证券 深圳前海旭鑫 TX CAPITAL 晖锐私募 深圳市红筹投资 UBS 资产 汇华理财 深圳市华银精治 安联保险 汇泉基金 深圳望正 安信基金 惠理基金 深圳展博 百嘉基金 嘉合基金 深圳昭图 宝盈基金 嘉实基金 深圳资瑞兴 北京成泉 建信基金 太平资产 北京宏道 建信养老 泰康基金 北京人寿 交银保险 泰康资管 北京腾业 交银施罗德 泰信基金 北京中睿元同 金鹰基金 天晟国际 北银理财 九泰基金 天风证券 贝莱德基金 聚鸣投资 万和证券 博道基金 开源证券 万家基金 才华资本 立格资本 五矿证券 财通证券 连捷投资 西部利得 创金合信 麦高证券自营 西藏中睿合银 淳厚基金 民生加银 汐泰资管 德邦基金 民生银行 信达澳亚 东财电子 摩根士丹利 信银理财 |

东方基金
 东方证券
 东方资管
 东吴基金
 敦和资产
 丰琰投资
 富安达基金
 富国基金
 格林基金
 巨曦资产
 工银瑞信
 广东银石
 广东正圆
 广发基金
 广发证券
 广发资管
 广银理财
 广州惠泰
 广州由榕
 国海证券
 国金证券
 国融基金
 国泰基金
 国泰君安
 国泰君安投资
 国投瑞银
 国新投资
 海富通基金
 杭银理财
 杭州睿银
 和泰人寿
 恒邦兆丰
 弘毅远方
 宏道投资
 泓德基金
 华宝信托
 华创证券
 华福证券
 华金证券

南华基金
 南土资产
 南粤百富
 宁夏日盛
 农银汇理
 农银人寿
 诺安基金
 盘京投资
 磐厚动量
 鹏华基金
 平安基金
 平安资管
 浦银安盛
 前海恒汇丰
 群益投资
 人保资管
 人寿资管
 仁馨资本
 融捷投资
 融通基金
 上海呈瑞
 上海合远
 上海鹤禧
 上海竑观
 上海健顺
 上海金友创智
 上海名禹
 上海楠溪
 上海磐稳
 上海浦泓
 上海钦沐
 上海尚雅
 上海申九
 上海拾贝能信
 上海沃珑港
 上海五中
 上海向日葵
 上海胤胜
 上汽欣臻

兴业基金
 兴业证券
 兴银基金
 兴银理财
 玄元私募
 寻常投资
 亚太财险
 阳光资管
 易方达
 易知（北京）
 毅木资产
 银河金汇
 银华基金
 英大基金
 盈泰投资
 永赢基金
 誉辉资本
 运舟资本
 长安基金
 长城基金
 长江养老
 长江证券
 长江资管
 长信基金
 招商基金
 招商信诺
 浙商资管
 中保投资
 中和资本
 中金公司
 中金基金
 中金资管
 中欧基金
 中邮创业
 中邮基金
 中邮人寿
 中邮证券
 中再资产
 洲和资本

个人投资者：

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 周东生 | 董晶 | 周妍君 | 徐学东 | 王彬 |
| 李胜杰 | 焉立春 | 何敏儿 | 洪毓婷 | 黄秋月 |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>郑丽红 陈琳 邬健凯 吴建湘 金应华</p> <p>朱海然 曾玲玲 毛燕巧 赵小奕 林卫红</p> <p>季红 高逊 詹文 邓猛雄 谢祉淇</p> <p>孙勇 谷满仓 马世明 狄祥生 赵桂英</p> <p>徐东风 张天喜 朱天岭 杨正如 葛美谦</p> <p>周维 彭奕潮</p> |
| 会议时间 | 2024年11月19日-12月31日 |
| 会议地点 | 线上会议；公司会议室 |
| 上市公司 接待人员 姓名 | <p>董事长、总经理：周正宇</p> <p>董事会秘书：XIE MEI QIN</p> <p>证券部：程奔驰</p> |
| 投资者关 系活动主 要内容介 绍 | <p>经营情况简介</p> <p>炬芯科技是国内领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网 (AIoT) 领域提供专业集成芯片。公司目前主要产品广泛应用于蓝牙音箱、智能手表、无线家庭影院、无线电竞耳机、无线收发 dongle、无线麦克风、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧 AI 处理器等领域。</p> <p>2024 年前三季度，公司实现营业收入 4.67 亿元，同比增长 24.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,091.27 万元，同比增长 51.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,802.64 万元，较上年同期增长 31.23%。综合毛利率 47.13%，较去年同期增加 4.09 个百分点；报告期内，公司研发投入合计 1.6 亿元，同比增长 33.76%。</p> <p>Q1：前三季度营收增速较高的产品是哪些？</p> <p>答：公司增速较快的是蓝牙音箱 SoC 芯片、低延迟高音质无线音频 SoC 芯片和端侧 AI 处理器芯片产品。其中：在蓝牙音箱市场，公司在以哈曼、SONY 等为代表的国际一线品牌持续提升渗透率，获得了稳健的增长；在低延迟高音质无线音频芯片市场，公司把握无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机、无线麦克风市场有线转无线化的趋势，取得了同比显著增长；在端侧 AI 处理器市场，公司突出在低功耗下提供大算力的特点，为客户提供优秀的解决方案，产品出货量实现了倍数提升。</p> |

Q2: 公司对于收并购的方向和规划是什么?

答: 收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径, 近期相关政策的出台也体现出监管层对上市公司使用收并购工具的支持。公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行评估筛选, 后续如涉及相关重大事项, 公司将按照规定及时履行信息披露义务。

Q3: 公司的市场竞争优势和市占率目标是什么?

答: 公司拥有深厚的技术积累, 核心技术涵盖了高性能音频 ADC/DAC 技术、高性能低功耗的蓝牙通信技术、高带宽低延迟私有无线通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术等。我们坚持以优越的性能规格、完备的服务支持以及稳定可靠的质量控制, 持续提升在国际头部音频品牌的渗透率, 同时在产品规划和技术迭代上也与大客户做到同频共进。从去年以来, 公司采取了大客户战略, 聚焦资源不断提升在品牌客户的市场占比, 中期目标是在现有基础上实现倍数的提升。

Q4: 客户集中度变化以及带来的效果如何?

答: 过去的一年时间, 公司在经营过程中做到了更多的聚焦, 客户集中度得到了较为明显的提升, 国际一线品牌客户在营收贡献比例上逐步增加。相应的, 我们和一线品牌客户的合作达到了预期的目标, 一方面订单的能见度更加清晰以及稳定性更强, 另一方面我们的研发团队也在合作交流中, 共同探索并引领所在领域的技术创新和规格指标。

Q5: 公司三核架构产品的主要应用场景? 目前的进展如何?

答: 公司已正式发布最新一代基于 SRAM 的模数混合存内计算的端侧 AI 音频芯片, 采用 CPU+DSP+NPU 三核异构架构, 可在更低功耗下提供更高算力, 同时兼具更低的延迟和增强的安全性, 将在音频应用和端侧 AI 中发挥重要作用。产品共包括三个芯片系列: 第一个系列是 ATS323X, 面向低延迟私有无线音频领域; 第二个系列是 ATS286X, 面向蓝牙 AI 音频领域; 第三个系列是 ATS362X, 面向 AI DSP 处理器领域。目前部分客户已接近终端产品量产阶段。

Q6: 公司基于新架构的产品 ASP 会有多少提升, 大概什么时候可以贡献营

收？

答：公司基于三核 AI 异构的芯片采用了更加先进的工艺制程，相较公司现有产品可以在现有功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升，而相较于市场上主流的 NPU 产品能效比可以提升至少三倍以上，相较于主流的 DSP 产品在功耗方面能降低接近 90%。因此在价格上相较公司上代产品也会有十分明显的提升，有望在明年贡献营收。

Q7：三核架构除了对当前的场景的应用，未来会拓展在哪些潜在的领域？

答：基于 SRAM 的模数混合存内计算技术路径下的端侧 AI 音频芯片平台具有非常广阔的应用前景，主要可以覆盖语音与音频、视觉识别以及健康类监测等相关应用场景，并且可实现端侧 AI 解决方案的快速落地。公司也将积极打造 AI 开发生态，借助炬芯完整工具链轻松实现算法的融合，帮助客户迅速地完成产品落地，助力 AIoT 产品 AI 化的不断演进。

Q8：研发人员以及研发支出的变化趋势？

答：技术研发是公司业绩增长的重要驱动力，而公司在取得业绩增长的同时也会持续加大研发投入，因此研发团队以及研发支出会相较去年同期有所增长，这个趋势将会继续保持。

Q9：公司在新品研发方面的进展如何？

答：公司持续对各产品线进行研发迭代，尤其是基于 SRAM 的模数混合存内计算的三核 AI 异构也将助力公司围绕 AIoT 领域应用的落地持续推出更有竞争力的新品。新品研发周期大概为一年半至两年，当在研产品达到相应节点后，公司会向市场公布新品的型号规格。

Q10：端侧 AI 处理器目前的落地场景？

答：公司的端侧 AI 处理器芯片当前主要应用在音频市场，相应的场景包括人声分离、AI 智能降噪等，公司发挥自身技术优势，可以为端侧产品提供低功耗下的 AI 算力，打造 AI 算力平台，将逐步拓展至音频之外的更多场景应用。

Q11：公司预期下一个具有较大潜力的品类和市场是什么？

答：在公司重点布局的低延迟高音质无线音频芯片市场，我们可以观察到无线家庭影院音响系统有望为公司带来较大的增长动力。目前我们已与电视机主机厂商合作推出了具有竞争力的产品解决方案，面向的客户主要在

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>欧美市场，随着内容端的日益丰富，消费者接受程度会进一步提升，公司将受益于家庭影院音响系统的无线化进程。</p> <p>此外，随着 AI 技术向端侧设备的不断演进和落地，AIoT 设备对于端侧 AI 处理器的需求也将呈现加速上升的趋势。针对端侧 AI 市场，我们认为采用存内计算的技术路径是满足端侧 AI 低功耗、大算力、高安全性等需求的有效手段。我们已正式发布最新一代基于 SRAM 的模数混合存内计算的端侧 AI 音频芯片，采用 CPU+DSP+NPU 三核异构架构，将以优异的产品性能大力挖掘市场需求。</p> <p>Q12: 海外品牌客户对于公司的销售收入贡献是趋势?</p> <p>答：从终端品牌的贡献来看，海外收入占比的提升是较为明显的，这更多是我们大客户战略与海内外市场复苏节奏差异在公司经营结果上的反映。公司将会继续深耕海内外头部品牌客户，力求清晰可见的增长空间和稳健的业绩增长。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2024 年 12 月 31 日</p> |